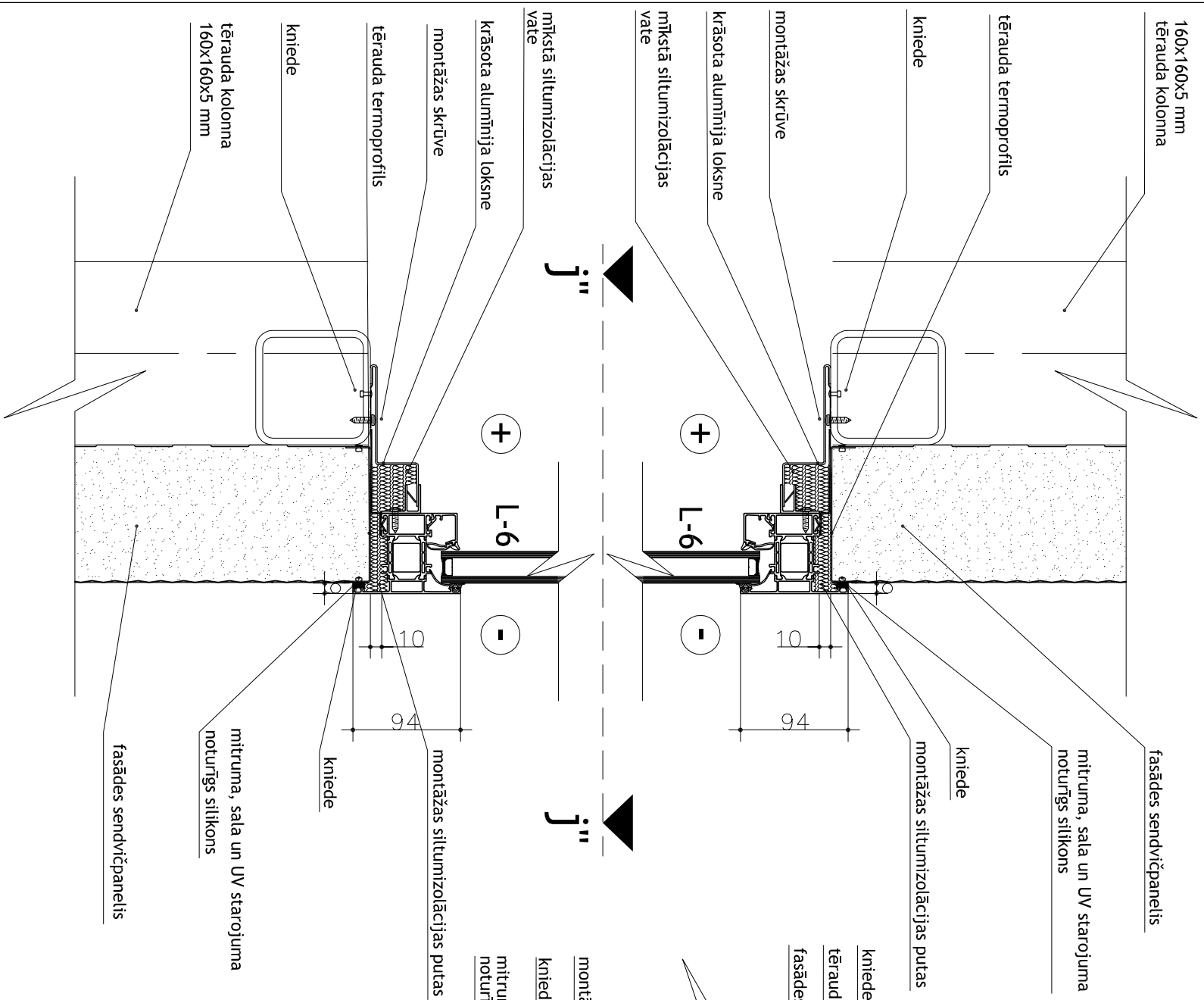
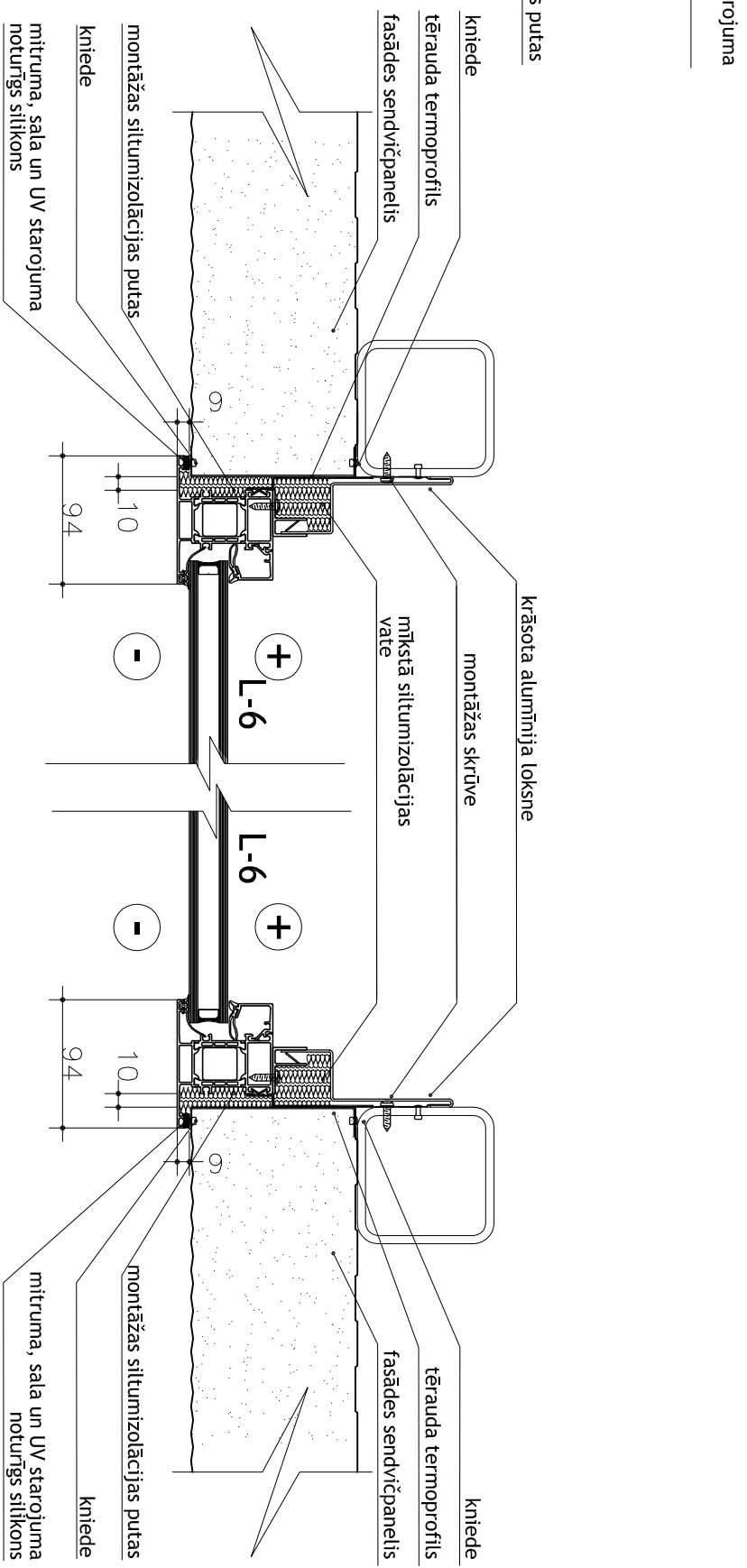


mezgls j'




mezgls j"-j"



PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti mm, augstuma atz. metros.
2. Fasādes apdare - horizontāli montēts sendvičpanelis KINGSPAN KS 1000 AWP ar slēptu horizontālo šuvi, paneļa b=120mm. Ārējās virsmas tips - Micro, paneļu saslēguma vertikālā šuve nosepta ar detaļu K185 (KINGSPAN sortiments)
3. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē ar 10cm pārtalidumu un jāizolē ar Tescon Invis lentu.
4. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē pamata virspusē.
5. Membrāna PRO CLIMA SOLITEX WA jālīmē parapeteta virspusē.
6. Rasējumā dotos izmērus lasīt, ja nepieciešama papildus informācija, bet rasējumā tā nav uzrādīta, vērsties pie arhitekta, mērīt rasējumu aizliegts.

Atbildīgais projektētājs		 ARHITEKTU BIROJS SIA "ER3" RĪGA, VIDRIČU 4-136, LV-1006	
BPV	RALFS ROZENVALDS		
Arhitektūras daļas vadītājs	RALFS ROZENVALDS		
Arhitekta	ELĪNA ROŽULAPA		
Arhitekta	NATAĻJA KUZNECOVA		
Pasūtītājs	Ventspils Brīvostas pārvalde	Pasūt. Nr.	VP-EC-12
Objekts	Elektronikas centra ēka Kaiju ielā 9, Ventspilī	Stādija	TP
		Lapa	ARD-501
		Mērogs	1:500
		Arh. reģ. Nr.	
Faīss	Mezgli_īestrades-2014_01_23.dwg	Datums	27.01.2014
Rasējums	Logu iebūve sendvičpaneļu sienā, Ventzils j, j"-j"		